

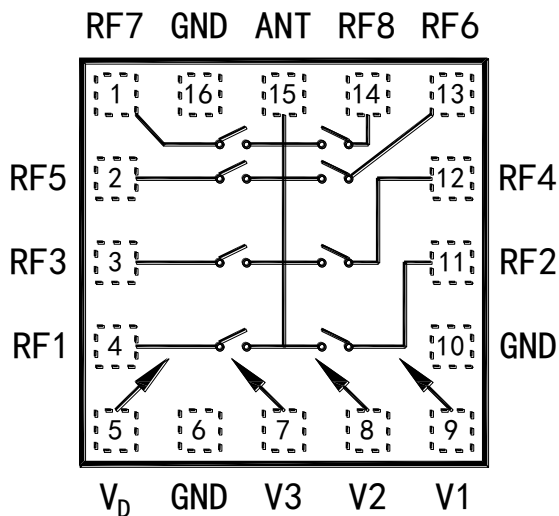
特点:

- 频率范围: 0.1~4.0GHz
- 插入损耗: 典型值 0.7dB
- 开关时间: 典型值 0.3us
- 单刀八掷反射式开关
- LGA 塑封
- 尺寸: 1.5×1.5×0.45mm

性能参数: (50Ω 系统)

参数名称	符号	测试条件	参数值				单位	备注
			常温 (+25℃)			全温		
			MIN	TYP	MAX	-55℃~+85℃		
频率范围	f	$V_D=+2.8V$ $f=0.1\sim 4.0GHz$ $P_{IN}=0dBm$ 控制电平: 0/+1.8V	0.1		4.0	0.1~4.0	GHz	
插入损耗	IL			0.7	1.2	≤1.5	dB	
输入驻波比	VSWR _I			1.2:1	1.7:1	≤2.0:1		
输出驻波比	VSWR _O			1.2:1	1.7:1	≤2.0:1		
隔离度	ISO			15	25		≥12	dB
1dB 压缩点输入功率	IP _{1dB}	f=0.1~4.0GHz	+25	+26		≥+24	dBm	
开关时间 ^①	t	$V_D=+2.8V$ $f=0.1\sim 4.0GHz$ $P_{IN}=0dBm$ 控制电平: 0/+1.8V		0.3	1.0	≤1.0	us	
上升沿	t _{RISE}			0.1	0.2	≤0.3	us	10% RF~90% RF
下降沿	t _{FALL}			0.1	0.2	≤0.3	us	90% RF~10% RF
控制电平	V _{TH}		+0.8	+1.8	+3.3	+0.8~+3.3	V	V1、V2、V3 端口
	V _{TL}		0		+0.3	≤+0.3	V	
谐波	2F ₀	F ₀ =617MHz~		-72	-62		dBm	+25℃
	3F ₀	960MHz@+26dBm		-64	-55		dBm	
	2F ₀	F ₀ =1710MHz~		-74	-66		dBm	
	3F ₀	1910MHz@+26dBm		-62	-53		dBm	
	2F ₀	F ₀ =2300MHz~		-74	-66		dBm	
	3F ₀	2700MHz@+26dBm		-62	-55		dBm	
电源电压	V _D		+1.8	+2.8	+3.3	+1.8~+3.3	V	
电源电流	I _D			0.5	1	≤1	mA	

注: ①开关时间: 开通时间=50% Ctrl~90% RF, 关闭时间=50% Ctrl~10% RF。

功能框图:

引脚定义:

引脚编号	符号	描述
1	RF7	射频端口 7, 内部无隔直
2	RF5	射频端口 5, 内部无隔直
3	RF3	射频端口 3, 内部无隔直
4	RF1	射频端口 1, 内部无隔直
5	V _D	电源端口, +2.8V
7	V3	控制端口 3, 0/+1.8V
8	V2	控制端口 2, 0/+1.8V
9	V1	控制端口 1, 0/+1.8V
11	RF2	射频端口 2, 内部无隔直
12	RF4	射频端口 4, 内部无隔直
13	RF6	射频端口 6, 内部无隔直
14	RF8	射频端口 8, 内部无隔直
15	ANT	天线端口, 内部无隔直
6/10/16/底部中央焊盘	GND	接地

极限参数表:

参数名称	极限值
输入射频功率	+36dBm (F0=950MHz, 20%DC, V _D =2.8V, V _{TH} =1.8V, Z ₀ =50Ω, TA=25℃)
电源电压	0~+3.6V
控制电压	0~+3.6V
装配温度	+260℃, 20s
工作温度	-55~+85℃
贮存温度	-65~+150℃
潮湿敏感等级 (MSL)	3
静电放电敏感度等级	1B

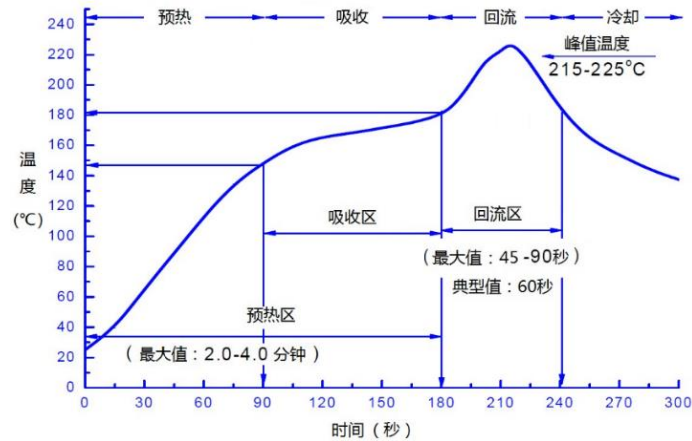
超过以上任何一项极限参数, 可能造成器件永久损坏。


真值表: (0: 0V, 1: +1.8V)

控制输入			射频开通通路
V1	V2	V3	
0	0	0	ANT-RF1
0	0	1	ANT-RF2
0	1	0	ANT-RF3
0	1	1	ANT-RF4
1	0	0	ANT-RF5
1	0	1	ANT-RF6
1	1	0	ANT-RF7
1	1	1	ANT-RF8

控制电流

状态	电压	电流 (典型值)
V _{TL}	0~+0.3V	0~0.2μA
V _{TH}	+0.8~+3.3V	0.5~1.0μA



此图为推荐回流温度曲线，因基板及回流焊设备性能不同而有所差异。请依据使用的基板与回流焊设备确认实际温度曲线，实测回流基板温度不得超过极限参数中装配温度。

5. 如特殊情况产品需进行返工返修处理，在返工返修前应按 IPC/JEDEC J-STD MSL3 级要求对器件进行烘烤处理，避免返工返修过程加热对器件造成热损伤。回流及返工返修次数不大于 3 次。
6. 如特殊情况需采用手工补焊，烙铁温度+350°C，焊接时间不超过 3 秒；回流及手工焊接次数不大于 3 次。
7. 产品在存储时需采用防静电托盘或防静电袋进行密封包装，存放条件：温度+10~+35°C，湿度 35~65%RH；需长期储存（超过半年）产品尽量在充氮干燥环境下存放。
8. 应用时应结合实际环境考虑是否对产品进行防护处理。对有盐雾防腐等要求的环境，在焊接及清洗完成后，应对产品进行三防喷涂处理，以提高产品耐环境适应性能力。